

仕様書

1. 件名 断熱材

2. 研究の概要

国立研究開発法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センターでは、省エネ向上が期待されるパワーデバイスの材料である SiC 単結晶の成長技術に関する開発研究を行っている。本研究テーマの「次世代グリーンパワー半導体に用いる SiC ウェハ技術開発」では、SiC バルク単結晶の高速成長技術開発を目指している。

3. 物品の概要

本件は、SiCデバイスのさらなる性能向上研究の根幹となるSiCバルク単結晶の高品質化・大口径化・高速成長を達成するための昇華法の研究に必要な断熱材である。本調達物品を使用する研究においては、材質CBCFの断熱材を用いた環境で成長条件を管理しており、調達物品はそれらと同一素材に限る。

4. 基本構成内容

4.1 断熱材の材質

CBCFであること。

4.2 形状・数量

加工形状: 別紙「断熱材 加工形状図面」参照

数量: 以下の表を参照

No.	名称	数量
1	大型断熱材下部内側(L150)	8
2	大型断熱材下部内側(L60)	8
3	大型断熱材下部カベ(ID294)	9
4	大型断熱材上部カベ(分割)(ID294)	38
5	大型断熱材上部カベ(最上部①)V2	4
6	大型断熱材上部カベ(最上部②)(ID294)	8
7	大型断熱材フタ	12
8	大型断熱材ソコ (内脚支持用)	9
9	D150T8プレート	40
10	5inch断熱材フタ	5
11	5inch断熱材ソコ	5
12	5inch断熱材カベ上段	3
13	5inch断熱材カベ中段	3
14	5inch断熱材カベ下段	3
15	断熱材押さえ 5 in 3	10

16	断熱材押さえ 5 in Φ 96	15
17	10inch断熱材用円柱	4

5. 納品確認試験等

以下が記載されている検査成績書を提出すること。

5.1 作製品の加工形状を示す図面または検査表一式

6. 納入の完了

本件は、「7. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

7. 納入物品

7.1 断熱材 一式

※各断熱材の梱包材表面に各物品の名称(「4.2 形状・数量」において指定した名称)を併記すること。

7.2 納入一覧表 1部(紙・電子媒体を問わない)

7.3 検査成績書(紙・電子媒体を問わない) 一式

7.3.1 作製品の加工形状を示す図面または検査表

※電子媒体の場合、原則としてUSBメモリ等の外部電磁的記録媒体は用いないこと。

8. 納入期限、及び納入場所

8.1 納入期限: 令和7年11月28日 (期限内、準備が整い次第可能な限り早い納入をすること)

8.2 納入場所: 茨城県つくば市小野川16-1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 西事業所
先進パワーエレクトロニクス研究センター 西-5E棟1106室

9. 付帯事項

9.1 本仕様書及び「断熱材 加工形状図面」の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。

9.2 本仕様書の「断熱材 加工形状図面」を希望する場合は、調達担当者へ申し出ること図面から知り得た情報に関しては本件の目的以外で利用しないこと。

9.3 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項、及び疑義が生じた場合は調達担当者との協議の上で決定する。

9.4 納入準備の整った納入物品について、納入可能なものを請求担当者との協議の上、速やかに分納すること。

- 以 上 -